

ATRM-4000

全自動ウェーハ表面保護テープ剥し機 Automatic Wafer De-Lamination System

【概要 - Outline -】

◆本装置は、ウェーハ裏面研磨工程後のウェーハ表面の保護テープを全自動で剥す装置です。
The ATRM-4000 is the ideal system for removing lamination tape from wafers, following the backgrind process.

【特長 - Features -】

- ◆ウェーハカセット部とメンテナンス部に仕切りを設け、メンテナンス部をクリーンルーム外に設置すること
State-of-the-art design to maintain the integrity of the lamination area and to achieve the best footprint.
により、高クリーン度の必要な室内のスペースを小さくすることができます。
- ◆ウェーハを特殊エレメントにより確実にホールドし、ウェーハにストレスを与えることなく剥離します。
Special table prevents from wafer breakage.
- ◆対話方式による簡単操作。
Ease of operation
- ◆FOUP カセット対応 (オプション)
FOUP option
- ◆AGV、OHT 通信機能対応可 (オプション)
AGV and OHT protocol options
- ◆紫外線照射ユニット内蔵 (オプション)
Option: UV unit
- ◆8・12インチ対応機
Applicable to 8" and 12" dia-wafer



仕様 Specification	ATRM-4000	
スループット Throughput	70 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	8・12 inch	
使用テープ幅 Tape Width	8 inch : W 50~75 mm / 12 inch : W 75~100 mm	
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC100V 単相 Single phase 50/60Hz 2.5KVA
	空気源 air	圧力 Pressure 0.4Mpa 100NI/min
	真空源 Vacuum source	-74 Kpa
装置寸法 Demension	W 1,350 × D 1,575 × H 1,800 mm	
重量 Weight	600 kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.